

# 2022 マイクロエレクトロニクスショー

## 『2022最先端実装技術シンポジウム』のご案内

主催：（一社）エレクトロニクス実装学会

2022年6月15日（水）から6月17日（金）の3日間にわたり、東京ビッグサイトで「JPCA Show 2022」と同時開催します（一社）エレクトロニクス実装学会主催「2022 マイクロエレクトロニクスショー」の特別イベントとして「最先端実装技術シンポジウム」を開催します。エレクトロニクス実装技術を取り巻く最新のトピックスについて、最先端の研究者、第一線の開発技術者にご講演をいただきます。ぜひ、皆様にご来場いただきたくご案内申し上げます。

### 1. 開催概要

- 1) 日時：2022年6月15日(水)から17日(金) 9時45分から16時20分
- 2) 会場：東京ビッグサイト 会議棟 6階
- 3) プログラム：下記プログラムによる。 (敬称略)

日時	6月15日(水)
会場	604会場
	15A1 9:45-12:30 座長：松本委員 副座長： セッションテーマ：5G/6Gに対応する基板・材料・プロセス最新動向
9:45-10:40	①高周波に対応する銅配線形成技術 - 新シード層を用いた“平滑面”への銅配線の形成 - DIC株式会社 富士川 亘
10:40-11:35	②BSGを見据えたフッ素系材料の技術・開発動向 AGC株式会社 細田 朋也
11:35-12:30	③高周波対応・特殊用途のFPC/Semi Flex PWBの採用事例 セミコンサルト 上田 弘幸
	15A2 13:35-16:20 座長：土門委員 副座長：齊藤委員
	セッションテーマ：次世代情報処理（AI、IoT等、量子コンピューター）・SDGsも背景にある？
13:35-14:30	①量子コンピューターの開発と導入（仮） 日本アイ・ビー・エム株式会社 山道 新太郎
14:30-15:25	②Quantum Transformation 量子コンピュータによる社会実装最前線 住友商事 寺部 雅能
15:25-16:20	③量子コンピューター開発におけるシリコン集積化技術の役割 産業技術総合研究所 森 貴洋

日時	6月16日(木)
会場	604会場
	16A1 9:45-12:30 座長：猪川委員 副座長：越地委員
	セッションテーマ：5G・6G通信端末市場と実装技術動向
	①5G・6G 通信端末市場と対応デバイス・実装技術動向 株式会社 富士キメラ総研 清水田 大典
	②5Gスマートフォンに見る半導体パッケージとその実装技術の動向 セミコンサルト 上田 弘幸
	③(仮)次世代パッケージ FOLP@の特徴と適用市場 アオイ電子株式会社 鈴木 敬史
	16A2 13:35-16:20 座長：三宅委員 副座長：池田委員
	セッションテーマ：CASEIに向けた車載機器実装技術の最新動向
	①日米中欧の分岐から読み解く2025年のEV像とそこに求められるパワーエレクトロニクス実装技術最前線 名古屋大学 未来材料・システム研究所 山本 真義
	②ワイドギャップ半導体向けパワーモジュール技術開発 大分デバイステクノロジー株式会社 杉木 昭雄
	③自動車レベル3時代の車載センサ技術の動向 セミコンサルト 上田 弘幸

日時	6月17日(金)
会場	604会場
	17A1 9:45-12:30 座長：本多委員 副座長：小岩委員
	セッションテーマ：新たな配線・実装がもたらすスマート衣料最前線(仮)
	①E-テキスタイル、スマートテキスタイルを取り巻く研究開発動向 東洋紡株式会社 前田 郷司
	②検討中 奈良女子大学/大阪大学大学院 才藤直樹
	③e-テキスタイル、導電糸とは？(仮) 福井工業技術センター 笹山 秀樹
	④E-テキスタイルによるバイタルセンシング ～心電データに基づくメンタル状態の表示システムANA I MTM～ 東洋紡株式会社 前田 郷司
	17A2 13:35-16:20 座長：猪川委員 副座長：和崎委員
	セッションテーマ：車載機器の高密度実装化に向けて
	①オートパイロット型統合ECUに見る実装技術動向（仮） 株式会社テカナリエ 清水 洋二
	②車載E/Eアーキテクチャーの進化に向けたECU実装構造とプリント配線板技術 株式会社メイコー 戸田 光昭
	③微細化するビルドアップ基板マイクロピアの信頼性問題 大阪大学 菅沼 克昭

日時	6月15日(水)
会場	605会場
	15B2 13:35-16:20 座長：西田委員 副座長：小岩委員
	セッションテーマ：3D-ICが見つめる先には、実装技術の挑戦と課題
13:35-14:30	①次世代ノードの鍵を握る3D集積技術の進化と応用へ向けた取り組み 横浜国立大学 井上史大
14:30-15:25	②最先端ダイ/ウェーハレベル直接接合技術による3Dおよびヘテロ集積化 イーヴィングループジャパン株式会社 山本 宏
15:25-16:20	③ Overview and Initiatives of TSMC Japan 3DIC R&D Center (仮) TSMCジャパン3DIC研究開発センター株式会社 市川公也

日時	6月16日(木)
会場	605会場
	16B1 9:45-12:30 座長：西田委員 副座長：内木場委員
	セッションテーマ：DX社会実現に向けて、、、半導体産業復活はあり得るのか？何ができるか、何をなすべきか
	①(仮) 日本半導体産業の復興なんて幻想だ 微細加工研究所 湯之上 隆
	②パッケージ市場での日本の強みと今後のビジネスチャンス(仮) AZサプライチェーンソリューションズ 亀和田忠司
	③半導体産業の変貌と今後の展開～海外から学ぶニッポン復活のシナリオ 国際技術ジャーナリスト兼 セミコンポータル編集長 津田 建二
	16B2 13:35-16:20 座長：土門委員 副座長：渡邊委員
	セッションテーマ：SDGs・カーボンニュートラル
	①カーボンニュートラル社会実現に向けた取り組み 株式会社IHJ 大原謙治
	②新たな成長期に入ったエレクトロニクス/半導体市況展望 ～ポストコロナで加速するDX、GX、メタバースで半導体産業成長シナリオが変化する～ インフォマインテリジェンス合同 南川 明
	③カーボンニュートラルの実現に向けた新戦略 みずほフィナンシャルグループ 末吉 光太郎

日時	6月17日(金)
会場	605会場
	17B1 9:45-12:30 座長：三宅委員 副座長：土門委員
	セッションテーマ：e-Axleと電池
	①eAxle（イーアクスル）の最新動向（仮） 産業タイムズ 高澤里美
	②自動車エレクトロニクス技術動向 ～電気自動車と自律運転に向けて～ インターコネクション・テクノロジー(株) 宇都宮久雄
	③全固体電池の最新動向（仮題） 東京工業大学 一杉 太郎
	17B2 13:35-16:20 座長：西田委員 副座長： セッションテーマ：Beyond5Gへの挑戦、新しい実装技術への取り組みとソリューションの提案
	①半導体産業のこれからの3D-IC実装技術の現状と課題、アカデミアからの提案 東北大学 福島善史
	②実装技術の変遷と今後の展望 東レエンジニアリング 晴 孝志
	③企業連携による半導体パッケージ評価プラットフォーム(JOINT2) 昭和電工マテリアルズ株式会社 満倉一行

※本プログラムは、断りなく変更になる場合があります

#### 4) 料金

##### ①聴講料

会 員：3日間 一律 10,000円（3日間聴講できます）

一 般：3日間 一律 15,000円（3日間聴講できます）

JIEPシニア会員：3日間 一律 2,000円

名誉会員／学生：無料

※会員とは、JIEP 正会員、賛助会員会社 社員、JPCA 会員会社 社員、  
JARA 会員会社 社員

※聴講料金には講演データは含まれておりません。

##### ②講演データ料

聴講される方 : 10,000円（3日分）

データのみ購入の方 : 25,000円（3日分）

\*講演終了後 オンデマンド配信も予定しております。参加された方は  
オンデマンド視聴も可能です。但し講演者の許可を得た講演に限ります  
ので、ご容赦願います。

（オンデマンドのみの視聴の方の申し込みは別途受け付けます。）

#### 5) 申込方法

① 展示会公式ホームページ (<http://www.jpccashow.com/show2022/>) より申込みください。

## 2. お問い合わせ先

一般社団法人エレクトロニクス実装学会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館1階

TEL：03-5310-2010 FAX：03-5310-2011 E-mail：[symp@jiep.or.jp](mailto:symp@jiep.or.jp)